2021 年 12 月吉日
奥野製薬工業株式会社 企画開発室

第 23 回半導体・センサ パッケージング技術展出展のご案内

拝啓　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
　今般、弊社は 2022 年 1 月 19 日(水)～21 日(金)に東京ビッグサイトで開催されます第 23 回半導体・センサ パッケージング技術展に出展致します。近年、特に力を入れているパッケージ用表面処理薬品、パワーデバイス関連製品を始めとして、電磁波対策向けや絶縁材料などの製品を展示致します。
　弊社のブースは東 3 ホールの【24-12】です。社員一同、皆様のお越しを心よりお待ちしております。

敬具

記

次世代プリント配線板, パッケージ用表面処理

・超微細配線向け硫酸銅めっき添加剤
・大口径ビア対応硫酸銅めっき添加剤
・高い膜厚均一性を有する硫酸銅めっき添加剤
・銅バンプ形成用硫酸銅めっき添加剤
・TSV フィリング用硫酸銅めっき添加剤
・超微細回路形成用無電解銅めっきプロセス
・ガラス基板への無電解銅めっきプロセス
・還元型コバルト触媒を利用した
　ボイドフリー最終表面処理

パワーデバイス用表面処理

・ウエハ上のアルミニウム電極用 UBM 形成プロセス
・耐クラック性に優れたパワーデバイス用
　無電解ニッケルめっき液
・ナノ銀焼結接合用に適した
　銅上の無電解銀,ニッケル/銀めっき液

次世代を担うフレキシブル素材向け表面処理

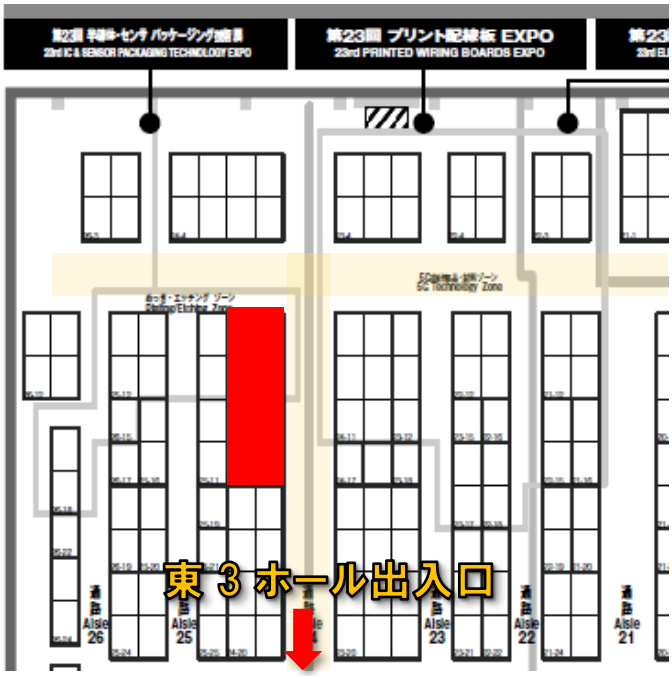
・Roll to Roll 装置対応硫酸銅めっき添加剤
・高周波高速伝送に適した LCP フィルムへの
　無電解銅めっきプロセス

低周波電磁波シールド

・浴安定性の高いニッケル-鉄合金めっき用添加剤
・膜厚均一性に優れる
　無電解ニッケル-鉄合金めっき液

絶縁材料

・電子部品産業をアシスト！
　電子デバイス用ガラス製品
・高絶縁・高耐熱性コーティング剤
・粉末用高絶縁・高耐食性コーティング剤
・ジルコニアナノ粒子分散液



東 3 ホール

奥野製薬工業株式会社

小間番号 24-12

東 3 ホールの出入口から入って、大通りを直進
大通りとの交差点の四つ角

展示会の詳細に関しましては、左記の QR コードよりご確認ください。
第 23 回半導体・センサ パッケージング技術展 公式ホームページ

以上

奥野製薬工業株式会社
〒538-0044 大阪市鶴見区放出東 1-10-25
お問合せ先 企画開発部 企画開発室 Tel.06-6961-0886